

## 通富微电子股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）370号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）98,310,291股，发行价格为每股13.02元，应募集资金总额为人民币128,000万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,716万元后的募集资金为人民币125,284.00万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司中国银行南通分行491066628196账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用224.83万元后，本公司本次募集资金净额为人民币125,059.17万元。

上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZA0161号验资报告验证。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

##### 1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目38,543.68万元，永久性补充流动资金12,059.17万元。尚未使用的募集资金余额为76,229.86万元（其中募集资金74,456.32万元，募集资金专户理财收益1,614.55万元，专户存储累计利息扣除手续费158.99万元），扣除为募投项目开立信用证的保证金

6,379.40万元、理财资金57,000.00万元，募集资金专户存储余额为12,850.46万元。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入“移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目”募集项目36,825.68万元。

(2) “智能电源芯片封装测试项目”变更用于收购Advanced Micro Devices, Inc.间接持有的超威半导体技术(中国)有限公司及Advanced Micro Devices Export SDN.BHD各85%的股权，以募集资金34,000万元及其产生的利息和理财收益1,029.61万元投入。

综上，截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目75,369.36万元，永久性补充流动资金12,059.17万元，变更募集资金用途用于股权收购项目35,029.61万元(含该募集资金产生的利息和理财收益1,029.61万元)，累计投入122,458.14万元。尚未使用的募集资金余额为5,241.00万元(其中募集资金3,630.64万元，募集资金专户理财收益1,209.32万元，专户存储累计利息扣除手续费401.04万元)，扣除为募投项目开立信用证的保证金2,219.60万元、募集资金专户存储余额为3,021.40万元。

## 二、募集资金的管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于2014年6月28日经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对

募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存储余额	备注
中国银行股份有限公司南通分行	491066628196	30,201,812.2	
中国农业银行南通分行营业部	10707001040224838	0.00	已销户
中国工商银行南通分行营业部	1111822229100525370	12,179.90	
<b>合 计</b>		<b>30,213,992.</b>	

1、上表存储余额中，已计入募集资金专户理财收益1,209.32万元、已计入募集资金专户存款利息扣除手续费净额401.04万元，已扣除为募投项目开立信用证的保证金2,219.60万元。

2、经2015年4月27日第五届董事会第四次会议、2015年5月11日第五届董事会第五次会议决议，本公司使用临时闲置募集资金购买保本型理财产品，最高额度不超过9.3亿元（含本数）。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金临时闲置资金购买保本型理财产品共计442,000.00万元，已全部到期。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年4月11日，经本公司2016年第二次临时股东会决议，同意终止“智能电源芯片封装测试项目”，并将相关募集资金变更投资于“南通富润达投资有限公司增资暨收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权项目”（以下简称“收购AMD子公司股权项目”），即将增资资金用于收购Advanced Micro Devices, Inc. 间接持有的超威半导体技术（中国）有限公司及Advanced Micro Devices Export SDN. BHD

各85%的股权。

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

## 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2016年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

### 附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

通富微电子股份有限公司董事会

2016年3月16日

附件 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		125,059.17				本年度投入募集资金总额	70,825.68			
报告期内变更用途的募集资金总额		34,000.00				已累计投入募集资金总额	121,428.53			
累计变更用途的募集资金总额		34,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		27.19%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目	否	79,000.00	79,000.00	36,825.68	75,369.36	95.40	2017年6月30日	4,271.47	否	否
智能电源芯片封装测试项目	是	34,000.00	--	--	--	--			不适用	是
永久补充流动资金	否	15,000.00	12,059.17		12,059.17	100.00			不适用	否
收购 AMD 子公司股权项目	是	--	34,000.00	35,029.61	35,029.61	103.03		1,364.93	不适用	否
<b>小计</b>		<b>128,000.00</b>	<b>125,059.17</b>	<b>71,855.29</b>	<b>122,458.14</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,636.40</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目累计实际效益未达到预计效益的 80%以上，主要由于募集资金尚未全部使用；而且，该项目由本公司负责实施，购买的设备在尚未独立布置生产线前，部分已购置设备实现的产量只能反映在本公司整体经营效益中，未单独计算该部分设备实现的效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于市场原因，PDFN 系列集成电路封装测试产品需求增长低于预期，“智能电源芯片封装测试项目”如按原计划投入，很难达到预期目标。经本公司 2016 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第十四次会议、2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，同意终止“智能电源芯片封装测试项目”，并将相关募集资金用途变更为“南通富润达投资有限公司增资暨收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权项目”，将增资资金用于收购 Advanced Micro Devices, Inc. 间接持有的超威半导体技术（中国）有限公司及 Advanced Micro Devices Export SDN. BHD 各 85%的股权。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于〈使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金〉的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 17,810.92 万元，全部为移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目支出。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2016）第 110ZA2896 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	经 2015 年 4 月 27 日第五届董事会第四次会议、2015 年 5 月 11 日第五届董事会第五次会议决议，本公司使用临时闲置募集资金购买保本型理财产品，最高额度不超过 9.3 亿元（含本数）。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金临时闲置资金购买保本型理财产品共计 442,000.00 万元，已全部到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，除用于购买理财产品 57,000 万元外，其余尚未使用的募集资金 12,850.46 万元均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购 AMD 子公司股权项目	智能电源芯片封装测试项目	34,000.00	35,029.61	35,029.61	1.03	不适用	1,364.93 (注1)	不适用(注2)	否
<b>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</b>			由于市场原因，PDFN 系列集成电路封装测试产品需求增长低于预期，“智能电源芯片封装测试项目”如按原计划投入，很难达到预期目标。经本公司 2016 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第十四次会议、2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，同意终止“智能电源芯片封装测试项目”，并将相关募集资金用途变更为“南通富润达投资有限公司增资暨收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权项目”，将增资资金用于收购 Advanced Micro Devices, Inc. 间接持有的超威半导体技术（中国）有限公司及 Advanced Micro Devices Export SDN. BHD 各 85% 的股权。						
<b>未达到计划进度的情况和原因</b>			不适用						
<b>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</b>			不适用						

注 1：本年度实现效益的计算是以 AMD 子公司收购完成后 5-12 月实际净利润为基数、按募集资金投入占股权收购款的比例计算而来。

注 2：根据本公司 2014 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书，移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目预计前两年为建设期，项目实施达产后预计平均年税后利润 9,855 万元；收购 AMD 子公司股权项目未作效益承诺。